



## 113 年度工研院南分院雷射技術、資通訊技術 與積層製造技術等相關研發成果讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 37 案 58 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」共分為：

- （一）雷射技術：19 案 27 件；
- （二）資通訊技術：13 案 19 件；
- （三）積層製造技術：5 案 12 件。

「讓與標的」並無共有專利，「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）113 年 3 月 27 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 113 年 3 月 26 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「113 年度工研院南分院雷射技術、資通訊技術與積層製造技術等相關研發成果讓與案：公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 113 年 3 月 26 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 113 年 4 月 9 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

（一）本讓與案採通訊或親送方式投標。

投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

- 1.（密封）價格封。



2. 押標金。
3. 公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）。
4. 近兩年財報資料。
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。（若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。）

（以下統稱「投標文件」），裝入信封密封之，並在信封上註明「113 年度工研院南分院雷射技術、資通訊技術與積層製造技術等相關研發成果讓與案投標」，於截標日 113 年 4 月 9 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 桂小姐收。

（二）廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額。

（三）商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介（20%）
2. 公司財務狀況（20%）
3. 公司營運／研發能力（20%）
4. 「讓與標的」運用規劃（30%）
5. 國內產業效益（10%）

（如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等）

（四）投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。（「讓與標的」以同一發明為一案。）

（五）本讓與案不得共同投標或重複投標。

（六）投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

（七）投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

## 六、押標金：

（一）押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格，但經工研院同意者，不在此限。

（二）押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。



(三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

(一) 投標時間截止後之投標。

(二) 開標前業已公告停止本讓與案交易程序。

(三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。

(四) 投標單附加任何成交條件者。

(五) 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。

(六) 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標時未能補足者，其投標為無效。

(七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。

(八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

(一) 分為初審（開標日為 113 年 4 月 16 日）及複審（決標日為 113 年 4 月 24 日），投標廠商於通過初審後，始能進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。

(二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。

(三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書進行書面審查及確認。

(四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會會議就商業營運計畫書進行複審，投標廠商於決標日應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。

(五) 投標廠商若有境外實施需求，除於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額，並於複審時報告說明。

(六) 複審時，工研院開標審議委員會將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標廠商金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商可優先有一次加價機會，若此加價仍無超過底價，之後則由所有投標廠商同時議價，所有投標廠商之間的同時比增價格以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上投標廠商總評比分數均超過及格分，投標金額亦均超過底價且相同，得提供投標廠商議價機會，並以高價者決標。比增價格以三次為限，若比增三次後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。（議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書）



- (七) 決標時將請律師到場監標。
- (八) 決標後將個別通知投標廠商決標結果（不公告得標廠商）。
- (九) 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

## 九、契約事項：

- (一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
- (二) 得標廠商如屆期末與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。
- (三) 得標廠商與工研院簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。
- (四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
- (五) 得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
- (六) 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：
  1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
  2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；

3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。

- (九)得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
- (十)「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
- (十一)「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部產業技術司，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：
- 1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
  - 2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
  - 3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
  - 4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。
- (十二)得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與

契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

- 1.得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
- 2.得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
- 3.為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

(十三) 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前書面通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與後手之讓與契約，否則即視為將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」。

(十四) 得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

(十五) 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

(十六) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，



應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

(十七)得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

## 十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人(請詳十二、聯絡方式)聯絡，取得投標單。

## 十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

## 十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心桂小姐

電話：+886-3-591-8009

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：[ManTing@itri.org.tw](mailto:ManTing@itri.org.tw)

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



## 附件：專利清單

### (一) 雷射技術：19 案 27 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
1	1	P27000034TW	均勻打光之掃描式視覺系統	中華民國	獲證	I448730	20140811	20311024	經濟部產業技術司	
2	2	P27010064TW	光束產生裝置	中華民國	獲證	I499146	20150901	20321216	經濟部產業技術司	
3	3	P27010065TW	間隔時間可調脈衝序列產生裝置	中華民國	獲證	I473373	20150211	20321129	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
	4	P27010065US	間隔時間可調脈衝序列產生裝置	美國	獲證	8995054	20150331	20330709	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
4	5	P27010066TW	時間差調制旁波段增益短脈衝雷射輸出裝置	中華民國	獲證	I469462	20150111	20321129	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
	6	P27010066US	時間差調制旁波段增益短脈衝雷射輸出裝置	美國	獲證	8831052	20140909	20330527	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
5	7	P27030026CN	脈衝激光系統	中國大陸	獲證	ZL201410768007.8	20190531	20341211	經濟部產業技術司	
	8	P27030026TW	脈衝雷射系統	中華民國	獲證	I566488	20170111	20341117	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
6	9	P27040025TW	複合材料貼合裝置	中華民國	獲證	I611910	20180121	20351130	經濟部產業技術司	
	10	P27040025US	複合材料貼合裝置	美國	獲證	10052855	20180821	20361128	經濟部產業技術司	
7	11	P27040027CN	拋光裝置及其拋光方法	中國大陸	獲證	ZL201610007818.5	20181002	20360105	經濟部產業技術司	
	12	P27040027TW	拋光裝置及其拋光方法	中華民國	獲證	I579093	20170421	20351112	經濟部產業技術司	
8	13	P27040031TW	加快雷射二極體發光的控制方法	中華民國	獲證	I575829	20170321	20351124	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
9	14	P27040032TW	雷射加工裝置及其方法	中華民國	獲證	I607820	20171211	20351112	經濟部產業技術司	
10	15	P27980058TW	以飛秒雷射製作多晶矽圖案的方法和系統	中華民國	獲證	I406106	20130821	20291112	經濟部產業技術司	
11	16	P27980083TW	雙脈衝光產生裝置及其雙脈衝光產生的方法	中華民國	獲證	I421543	20140101	20291203	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
	17	P27980083US	雙脈衝光產生裝置及其雙脈衝光產生的方法	美國	獲證	8422134	20130416	20310805	經濟部產業技術司	
12	18	P27990046TW	雷射倍頻模組	中華民國	獲證	I470887	20150121	20301213	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
13	19	P27990056CN	移除玻璃板材邊緣缺陷的裝置及其方法	中國大陸	獲證	ZL201010607453.2	20141210	20301226	經濟部產業技術司	
	20	P27990056TW	移除玻璃板材邊緣缺陷之裝置及其方法	中華民國	獲證	I400137	20130701	20301216	經濟部產業技術司	
14	21	P27990112TW	應用於雷射加工之深度即時監控系統及其方法	中華民國	獲證	I414385	20131111	20310804	經濟部產業技術司	
15	22	P70050008TW	雷射系統及雷射炫彩加工方法	中華民國	獲證	I630974	20180801	20361101	經濟部產業技術司	
16	23	P70050009TW	雷射裝置	中華民國	獲證	I605788	20171121	20361025	經濟部產業技術司	
17	24	P70050010CN	激光驅動電路及其控制方法	中國大陸	獲證	ZL201710367506.X	20190726	20370522	經濟部產業技術司	
	25	P70050010TW	雷射驅動電路及其控制方法	中華民國	獲證	I603556	20171021	20361030	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
18	26	P70060010TW	高功率雷射系統	中華民國	獲證	I630769	20180721	20371108	經濟部產業技術司	
19	27	P27030001TW	升壓裝置及串聯型變壓器裝置	中華民國	獲證	I513166	20151211	20340515	經濟部產業技術司	曾非專屬授權



(二) 資通訊技術：13 案 19 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
20	28	P27000041TW	主控裝置、被控裝置、及其網路通訊方法	中華民國	獲證	I484789	20150511	20311229	經濟部產業技術司	
	29	P27000041US	主控裝置、被控裝置、及其網路通訊方法	美國	獲證	9722875	20170801	20341117	經濟部產業技術司	
21	30	P27010019TW	行動軌跡分析方法與系統	中華民國	獲證	I488521	20150611	20321122	經濟部產業技術司	
22	31	P27010034TW	資訊推薦方法及系統	中華民國	獲證	I499290	20150901	20321129	經濟部產業技術司	
23	32	P27010077TW C1	文字串流訊息分析系統和方法	中華民國	獲證	I501097	20150921	20330708	經濟部產業技術司	
24	33	P27020023TW	產生項目建議的方法和系統以及非臨時性介質	中華民國	獲證	I533249	20160511	20340609	經濟部產業技術司	
25	34	P27030050TW	路由封包以控制網路流量的方法及使用該方法的裝置	中華民國	獲證	I568290	20170121	20350318	經濟部產業技術司	
26	35	P27040020TW	用以分析瀏覽記錄及其文件之方法及其系統	中華民國	獲證	I571756	20170221	20351210	經濟部產業技術司	
	36	P27040020US	用以分析瀏覽記錄及其文件之方法及其系統	美國	獲證	10467255	20191105	20371021	經濟部產業技術司	
27	37	P27040021TW	多請求的排程方法及排程裝置	中華民國	獲證	I584667	20170521	20351126	經濟部產業技術司	
	38	P27040021US	多請求的排程方法及排程裝置	美國	獲證	10089149	20181002	20360814	經濟部產業技術司	
28	39	P27970052TW	適型接觸介面之姿態偵測方法及其系統與姿態調適方法	中華民國	獲證	I363614	20120511	20280916	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
	40	P27970052US	適型接觸介面之姿態偵測方法及其系統與姿態調適方法	美國	獲證	9125594	20150908	20281209	經濟部產業技術司	
29	41	P27980026TW	生物力學分析系統與方法	中華民國	獲證	I502389	20151001	20291116	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
30	42	P27980075TW	活動力監測方法與系統	中華民國	獲證	I401061	20130711	20291215	經濟部產業技術司	
31	43	P27990048TW	網路傳輸裝置及其頻寬管理方法	中華民國	獲證	I497950	20150821	20310504	經濟部產業技術司	
	44	P27990048US	網路傳輸裝置及其頻寬管理方法	美國	獲證	8879575	20141104	20320727	經濟部產業技術司	
32	45	P27990070TW	控制系統與其初始化方法	中華民國	獲證	I431445	20140321	20301221	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
	46	P27990070US	控制系統與其初始化方法	美國	獲證	9008851	20150414	20340201	經濟部產業技術司	曾非專屬授權

(三) 積層製造技術：5 案 12 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
33	47	P27020045DE	調控積層製造之裝置及其方法	德國	獲證	EP2891533	20191211	20340930	經濟部產業技術司	
	48	P27020045FR	調控積層製造之裝置及其方法	法國	獲證	EP2891533	20191211	20340930	經濟部產業技術司	
	49	P27020045GB	調控積層製造之裝置及其方法	英國	獲證	EP2891533	20191211	20340930	經濟部產業技術司	
	50	P27020045TW	調控積層製造之裝置及其方法	中華民國	獲證	I511823	20151211	20331219	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
	51	P27020045US	調控積層製造之裝置及其方法	美國	獲證	9884455	20180206	20351224	經濟部產業技術司	
	52	P27020045USD 1	調控積層製造之裝置及其方法	美國	獲證	10695977	20200630	20350720	經濟部產業技術司	

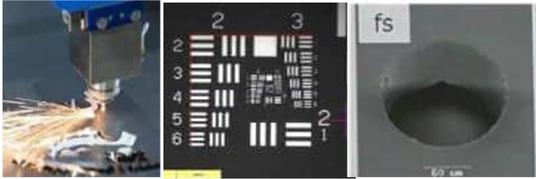


案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
34	53	P27040005TW	立體物件的積層製造方法	中華民國	獲證	I616314	20180301	20351221	經濟部產業技術司	
	54	P27040005US	立體物件的積層製造方法	美國	獲證	10303157	20190528	20370321	經濟部產業技術司	
35	55	P27040026TW	磁性元件的製造方法	中華民國	獲證	I576872	20170401	20351216	經濟部產業技術司	曾非專屬授權
	56	P27040026US	磁性元件的製造方法	美國	獲證	10259172	20190416	20370719	經濟部產業技術司	
36	57	P70050013TW	立體標籤、列印設備及其列印方法	中華民國	獲證	I599696	20170921	20361109	經濟部產業技術司	
37	58	P70060001TW	點膠裝置及方法	中華民國	獲證	I634953	20180911	20370327	經濟部產業技術司	

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。

## 讓與標的技術說明-雷射技術<sup>(1/3)</sup>

本次讓與專利  
**19案27件**



- 專利技術涵蓋雷射切/鑽技術、雷射加工關鍵模組技術、雷射加熱貼合技術、光學技術、電學技術以及製程技術等，雷射加工應用上，技術保護範圍完整。
- 專利包含台灣、大陸和美國等國別。
- 可應用於光電/半導體雷射加工、雷射光源光學系統、建築鋼構、石化管件、廠務管件焊接、面板與綠能產業等領域，即使現在已有彩色列印與雷射貼合先進技術，但市場仍需要雷射製程與雷射光路調控專利，因此專利技術應用範圍廣泛。
- 主要優勢為導入雷射加工智慧化、系統化、軟硬體整合，達成生產速度以及製程品質提升。

### 雷射技術

#### 雷射切/鑽技術

<1案2件>

控制雷射光能量密度和觸發時程，及路徑和移動速度，產生高溫低度差。

#### 雷射加工關鍵模組技術

<5案8件>

奈秒雷射技術，包含奈秒雙脈衝、奈秒雷射驅動電路與雷射炫彩加工技術。

#### 雷射加熱貼合技術

<1案2件>

碳纖複合材料貼合裝置具水平移動與壓力調整模組。

#### 光學技術

<4案5件>

奈秒雷射的雙脈衝及倍頻技術。雙脈衝光束產生技術，降低雷射光散班技術，與均勻打光之掃描式視覺技術。

#### 電學技術

<4案5件>

奈秒雷射的驅動電路技術與其監控技術。

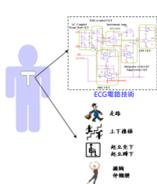
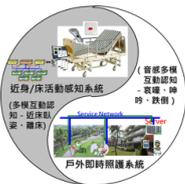
#### 製程技術

<4案5件>

奈秒雷射的拋光及炫彩製程技術。

## 讓與標的技術說明-資通訊技術<sup>(2/3)</sup>

本次讓與專利  
**13案19件**



- 專利技術涵蓋感測資料處理與融合及網路與通訊處理等，技術保護範圍完整。
- 專利包含台灣和美國。
- 可應用於網路管理、網路社群、人機互動以及居家健康照護等領域，提供相關產業終端產品專利保護，並降低開發風險。
- 有助於智慧家庭相關產業在人機介面、健康照護以及社群服務等網路設備提供競爭優勢。

### 資訊與通訊

#### 感測資料處理與融合

<8案11件>

生理、肌電、肌力、姿勢等感測資訊處理方法及裝置、健康管理系統。

#### 網路與通訊處理

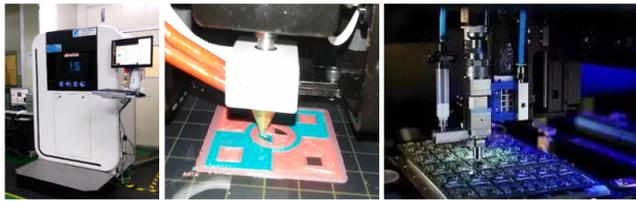
<5案8件>

網路資源管理、資料擷取、事件通報、社交關聯。

## 讓與標的技術說明-積層製造技術<sup>(3/3)</sup>

本次讓與專利

5案12件



- 專利技術為製程技術(金屬/非金屬)及控制技術(非金屬)，技術保護範圍完整。
- 專利包含台灣、美國、德國、英國及法國等國別。
- 可應用於金屬/非金屬積層製造、運動鞋服裝軟性材料圖案標籤等領域，即使現在已有更先進積層製造前製程及製程控制軟體技術，但市場仍需要積層製造製程及控制技術相關專利，因此專利技術應用範圍廣泛。
- 搭配智慧機器、加減法製程整合等，引領產業走向智慧化可量產技術發展，維持積層製造的產業優勢。

### 積層製造技術

#### 製程技術(金屬)

<3案10件>

金屬雷射積層製作技術在製造方法、模擬分析與控制技術軟硬體。

#### 製程技術(非金屬)

<1案1件>

立體標籤、列印設備及其列印方法。

#### 控制技術(非金屬)

<1案1件>

點膠裝置及方法，防止溢流與精微點膠固著鍵結強化技術。